

10/529765

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/030855 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B23K 3/08,  
1/012

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003311

(22) Internationales Anmeldedatum:  
26. September 2003 (26.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
102 46 540.1 30. September 2002 (30.09.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];  
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[DE/DE]: Theodor-Körner-Strasse 11, 16321 Bernau  
(DE). MÜLLER, Bernd [DE/DE]; Coethener Strasse 19,  
16259 Falkenberg (DE). WITTREICH, Ulrich [DE/DE];  
Strasse der DSF 1, 16727 Velten (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-  
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München  
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,  
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,  
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,  
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,  
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,  
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,  
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(72) Erfinder; und

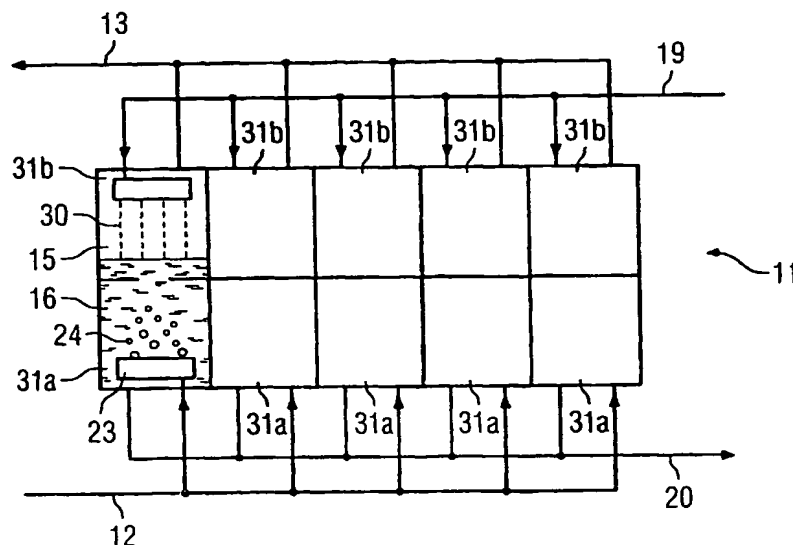
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MEIER, Hartmut

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CLEANING GAS DEVICE CLEANING THE PROCESS GAS OF A REFLOW SOLDERING SYSTEM

(54) Bezeichnung: REINIGUNGSVORRICHTUNG ZUR REINIGUNG VON PROZESSGAS EINER REFLOWLÖTANLAGE



(57) Abstract: Disclosed is a cleaning device (11) for the processing gas of a reflow soldering system and a method for the operation thereof. According to the invention, the cleaning device contains a cleaning fluid (16) enables non-cleaned process gas (12) to be guided, e.g. in the form of rising bubbles (24). The cleaned process gas is removed from the cleaning device (11). By using a cleaning fluid to separate impurities from the process, the invention is advantageous in comparison with conventional filters in that the process gas is subjected to little flow resistance, enabling the process gas to be cleaned in an efficient, low-cost matter.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/030855 A1